

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

2026 年半年度报告



厦门弘信电子科技集团股份有限公司（公章）

2026 年 8 月 24 日

声明与承诺

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示及释义

一、风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。本公司面临的重大风险与最近一期定期报告及债券募集说明书披露不存在重大变化。

二、释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司	指	厦门弘信电子科技集团股份有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

目录

风险提示及释义	3
第一章 企业及中介机构主要情况	5
一、 基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	7
一、 存续债务融资工具情况	7
二、 报告期内信用评级调整情况	8
三、 债务融资工具募集资金使用情况	8
四、 发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	8
五、 报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响	8
第三章 报告期内重要事项	10
一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	10
二、 财务报告非标准审计意见情况	10
三、 报告期内合并报表范围重大变化情况	10
四、 报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况 ..	10
五、 受限资产情况	10
六、 对外担保金额情况	11
七、 报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	11
第四章 财务报告	12
第五章 备查文件	13

第一章 企业及中介机构主要情况

一、基本情况

(一) 基本情况

企业中文名称	厦门弘信电子科技集团股份有限公司
企业中文简称	弘信电子
企业外文名称	<i>Xiamen Hongxin Electronics Technology Group Inc.</i>
企业外文简称	Hon-Flex
法定代表人	李强
注册资本	人民币 482,125,646.00 元
实缴资本	人民币 482,125,646.00 元
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 19 号之 2（1# 厂房三楼）
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 19 号之 2（1# 厂房三楼）
邮政编码	361101
企业网址	www.hon-flex.com
联系电话	0592-3160382
联系传真	0592-3155777
电子信箱	lixq@hon-flex.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	王坚
职位	董事会秘书
联系地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔海路 19 号之 2（1# 厂房三楼）
电话	0592-3160382
传真	/

电子信箱

hxdzstock@hon-flex.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率（%）	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人（如有）
1	厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2025 年度第一期科技创新债券	25 弘信电子 MTN001 (科创债)	10250175 5.IB	2025-12-09	2025.12.11	2027.12.11	2.00	3.48	每年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	厦门银行股份有限公司、浙商银行有限公司	厦门银行股份有限公司	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、债务融资工具募集资金使用情况

（一）报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

报告期内，发行人债券募集资金已使用完毕。

（二）报告期内变更债务融资工具募集资金用途情况

报告期内，发行人不存在变更债券募集资金用途情况。

（三）报告期内资金用于特定用途的具体情况（如有）

不涉及。

四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未触发发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及对债务融资工具投资者权益的影响

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具偿债计划及其他

偿债保障措施在报告期内未发生变化，公司按照募集说明书约定向债券投资者支付债券利息。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

无。

(二) 会计估计变更情况

无。

(三) 会计差错更正情况

无。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

截至报告期末，发行人所有权或使用权受到限制的资产账面价值合计【192,230.23】万元，具体资产明细及受限原因如下表所示：

单位：万元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,148.03	保证、质押：保证金及冻结资金
应收票据	135.34	未终止确认：已背书或贴现但尚未到期的应收票据
固定资产	140,090.55	抵押：抵押借款；融资性售后回租

无形资产	4,016.05	抵押：抵押借款
应收账款	21,840.26	质押：提供算力资源服务及销售算力设备合同项下担保
合 计	192,230.23	

六、对外担保金额情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人对外担保合计 0 万元。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章财务报告

厦门弘信电子科技集团股份有限公司已在深圳证券交易所网站披露了《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》，详情请见：

<https://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?8a32ddd6-2326-4b2e-a526-3b525afcfa12>

第五章备查文件

一、备查文件

(一) 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表、审计报告；

(二) 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址及网站

发行人：厦门弘信电子科技集团股份有限公司

法定代表人：李强

地址：福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路 19 号之 2(1#厂房 3 楼)

电话：0592-3160382

传真：0592-3155777

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（本页无正文，仅为《厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页）

厦门弘信电子科技集团股份有限公司



2026 年 8 月 24 日